

FH360无铅高温锡膏

High Temperature Lead-free Solder Paste

优势



服役温度高



环保无铅

Advantage



可靠性高



空洞率低



具有优异的润湿表现

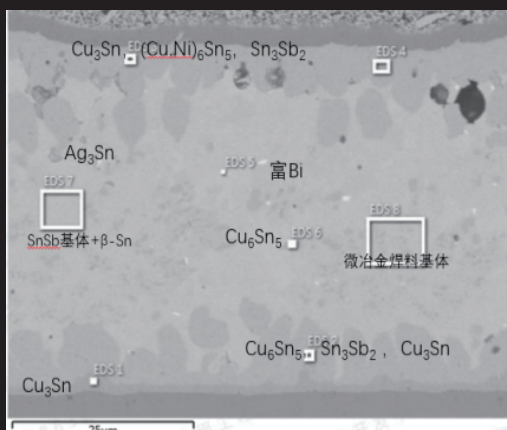


添加微纳米颗粒增强合金

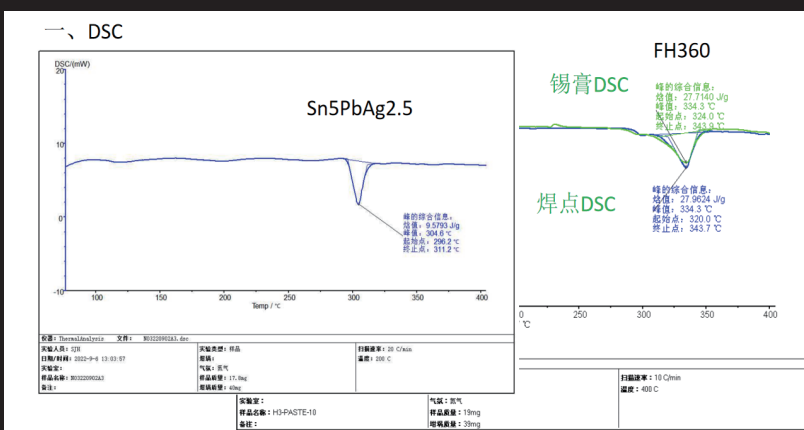
性能参数 Parameter

产品型号	FH-360	熔点	316-335°C
金属填料比例	75~90%	比重	3.5 - 4.5
卤素含量(Cl+Br)	< 1000ppm	存储寿命	6个月(-5~10°C)
焊点承受温度	> 280°C	抗拉强度	32.96Mpa
铜板腐蚀性	合格	残留物干燥度	合格
锡球测试	合格	润湿测试	合格
维氏硬度(Hv)	92.1		






产品特性 Product Features



焊点微观结构



FH360合金焊点的服役温度显著高于925, 在高温工作环境下拥有更高的可靠性。

微观形貌		陶瓷晶振芯片空洞图		空洞率
		FH360	 	2% , 2.5%
SPA925	 	4.2% , 8.2%		

焊点空洞率
仅为2%-4%
低于10%。

焊点剪切力 Shear force of the solder joint

